

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	1、佛山市上市协会 吴慧涛、秦瑜娜 2、广东大兴华旗 何海杰 3、汇融诚财富 陈绮锋 4、泰润海吉资产管理 罗少莹 5、玄甲私募基金 李大志、林佳义 6、方硕投资 董正 7、晟沅悦投资 刘志 8、赣晟投资 田小辉 9、宁聚投资 张雷 10、禅控私募基金 吉文钊 11、巨杉(上海)资产 张智晨 12、元吉资产 郭莉娜 13、凯鼎投资 刘剑辉、陈宁晖 14、天盈资产 刘志海 15、睿择投资 徐焯智 16、奶酪基金 郑丽敏 17、锦洋投资 朱韦潼 18、广发基金 吕真 19、华泰证券（上海）资产 李雅翔 20、马赫创富 李芮 21、千曲私募 候建庄 22、富业盛德 魏宏伟

	23、华泰证券 杨思羽、江惠枝、向文龙、沈天驰、季晨曦、邵凌、麦碧霞、丁一娜
时间	2023年10月30日
地点	佛山市禅城区古新路45号佛山市蓝箭电子股份有限公司5楼会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书张国光 2、证券事务代表林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1、2023年三季度财报显示，归母净利润4877万元，同比下降11.99%，请问净利润下降的原因？</p> <p>答：近年来国民经济经受了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，一定程度上抑制了消费欲望，家电、手机等应用需求下降，供需不平衡、议价能力下降，同时为提高竞争力，适应技术更新迭代，改良和更新产品，研发费用持续投入以及叠加上市费用支出等多重因素影响下，三季度净利润同比下降。</p> <p>2、请问公司对下游行业情况分析？</p> <p>答：首先，从产品下游应用领域看，公司产品主要应用于消费类电子、汽车电子、信息通信、电源电器、照明电路、工业自动化等领域。现在整个电子行业中汽车电子领域受益于新能源汽车的普及，景气度相对较好，市场需求有所增长；而其他消费类产品如手机、笔记本、PC目前整体需求有所下降；TV、路由器、空调等需求基本持平；其次，对于新型的消费类电子产品应用，如扫地机、洗地机、空气炸锅、蓝牙耳机等，此类产品适应市场需求变化波动较大。再次，目前受到宏观经济疲软和终端市场需求疲软的影响，消费信心不足，消费习惯偏保守等因素影响了电子产品需求。总体上，目前下游市场需求还在逐步恢复过程中。</p> <p>3、半导体企业扩张过快，是否存在产能过剩问题？</p>

答：行业扩产需结构化看待，目前随着新兴市场高端产品应用需求的提升，经过公司长期运营判断，目前市场产能需求还是属于良性发展；目前因为中美贸易摩擦等因素影响，半导体出现有短暂性过热发展的现状。

目前，半导体国产化占有率偏低，市场终端智能电子产品、清洁能源、大数据、AI 等各种技术不断发展产生新需求，同时、半导体本身技术也在不断更新迭代；宏观方面，国家在大力发展半导体技术。综上，未来半导体发展的空间依然乐观。

4、客户群体中包括士兰微、华润等 IDM 企业；小批量、定制化是否会提供服务？

答：半导体行业在几十年的发展过程中，不断进行整合和分工，形成目前合理化的分工体系。公司专业从事半导体的封装测试，多年来深耕半导体封装测试领域，在多项封装测试技术上拥有核心技术。公司凭借自身核心技术优势，一方面积极打造自有品牌，不断地为行业终端客户提供多种形式的半导体器件产品；另一方面服务半导体产业链，向 IDM、Fabless 公司等提供封装测试服务，多年来，公司凭借丰富的产品系列为客户提供一站式半导体封测产品及服务。

6、车规级产线与普通产线的区别？目前投入车规级产线是否较晚？有什么优势？

答：电子产品按照可靠性等级可分为：军工类、车规类、工业类及消费类产品。不同分类的产品应用环境差异较大，导致每个等级对应产品可靠性要求不一样。

公司拥有完整的车规级别的生产设备和 IATF16949 质量认证体系，已开发出多款车规级产品，能够实现新能源汽车等领域多项关键功能的驱动控制。目前公司的车规产品整体表现良好。

7、整个半导体行业在去库存阶段，公司对于先进封装的整

体规划是怎样？

答：公司作为一家主要从事半导体封装测试的国家级高新技术企业，具有较为完善的研发、采购、生产、销售体系。公司将结合半导体行业的发展趋势，将以研发中心项目建设为契机，推动公司封装技术迈上新台阶；聚焦应用于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G通信射频等具有广阔发展前景的新兴领域，进一步加大宽禁带功率半导体器件和 Clip bond 封装工艺等方面的研发创新；同时，公司将顺应集成电路封测技术发展趋势，将在晶圆级芯片封装以及系统级封装上加大投入。在已掌握的系统级封装 SIP 技术上，不断拓宽集成电路封测服务技术水平和产品覆盖范围，积极开展 SIP、IPM、MEMS、BGA 等多项封装平台的研究。集成电路封测产品在原有模拟电路基础上，逐步拓宽覆盖范围，拓展和提升数字电路和传感器等多个领域封测能力。此外，公司将扩大产品开发、优化产品结构，积极开拓新客户，提升公司产品品牌影响力，提高公司经营管理水平，致力将公司发展成为行业内领先的封测企业。

8、企业在行业地位、行业周期分析

答：公司目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，具备 12 英寸晶圆全流程封测能力，在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合，已形成年产超 150 亿只半导体的生产规模，分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，是华南地区重要的半导体封测企业。

由于半导体封测行业上游企业主要采购晶圆、铜等具备周期性特征的产品，下游领域主要面向消费类电子、工业、汽车电子等与宏观经济密切相关行业，因此半导体封测领域具备较为明显的周期性。

	<p>2022 年，受产品供需结构和行业周期下行交织影响，全球半导体市场由全面短缺转向结构性过剩，结束了 2021 年的大幅增长，而汽车和工业半导体需求仍然保持向好趋势。2023 年以来，面对复杂多变的国际形势，集成电路产业的战略性地位进一步凸显，各国围绕半导体行业的技术竞争态势和产业链博弈持续加剧，但由于通胀加剧以及智能手机、PC 等终端市场需求疲弱，导致内存需求大幅减少。</p> <p style="text-align: center;">9、公司对技术研发方面的情况分析</p> <p>答:首先，公司目前拥有完整的半导体封装测试技术，在金属基板封装、功率器件封装、半导体/IC 测试、超薄芯片封装、高可靠焊接、高密度框架封装、应用于半导体封装的机器人自动化生产系统、全集成锂电保护 IC、SIP 系统级封装等多方面拥有核心技术。公司具备 12 英寸晶圆全流程封测能力，掌握倒装技术，能够利用 SIP 系统级封装技术，针对多芯片重新设计框架，解决固晶、焊线、芯片互连、塑封等多项封装难题，并且已建立 DFN 封装系列平台，熟练掌握无框架封装技术。</p> <p>公司目前拥有一百多人组成的研发队伍，核心技术人员均拥有 20 年以上半导体行业工作经验，已形成了一支由高级工程师带队、工程师为骨干的优秀研发团队。此外，公司重视和科研院所等机构的合作研发，与中山大学、西安电子科技大学、工信部电子第五研究所等国内知名高校和研究机构进行紧密合作。</p> <p>为了满足公司未来业务的发展，公司拟在新建的生产大楼中重新规划建设研发中心。研发中心项目的建设能够整合现有的研发资源，为公司封测技术创新提供基础保障，缩短新产品新技术的研发周期，进一步提高公司的研发能力和科技创新能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 30 日